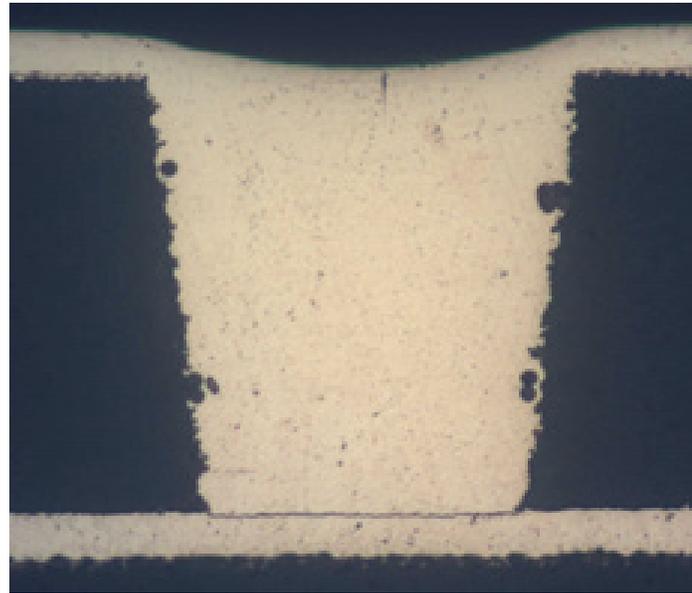


MacuSpec AVF-700

先进的填铜盲孔金属化

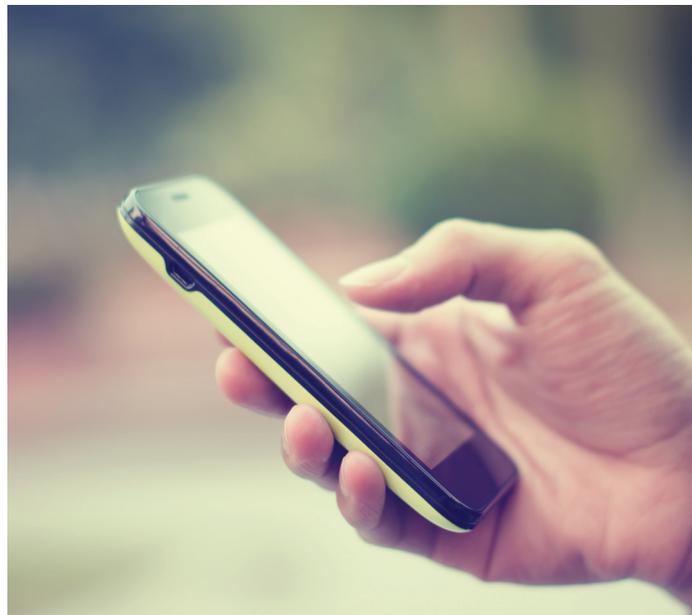
最小的电镀面铜厚填平不同孔径、纵横比的盲孔

MacDermid Enthone MacuSpec AVF 700以低成本、操作范围广的目标,用特殊的化学组份搭配一定的操作条件,可以在一个电镀槽中填平各种孔径的微盲孔。AVF 700是适用于任意层增层法的最佳产品,搭配我们的业界领先的直接电镀工艺,AVF 700是最先进的填孔选择。



主要特性优点

- 以最小的电镀面铜厚,可以满足孔径最大6 mil,最深4 mil盲孔填平
- 电镀填平后,减少或甚至不需要减薄铜厚度工序
- 通过CVS和常用的分析工具可以准确分析控制
- 孔金属化后不需要一次铜 (Flash plate)
- 搭配各种直接电镀工艺填孔



MacDermid Enthone

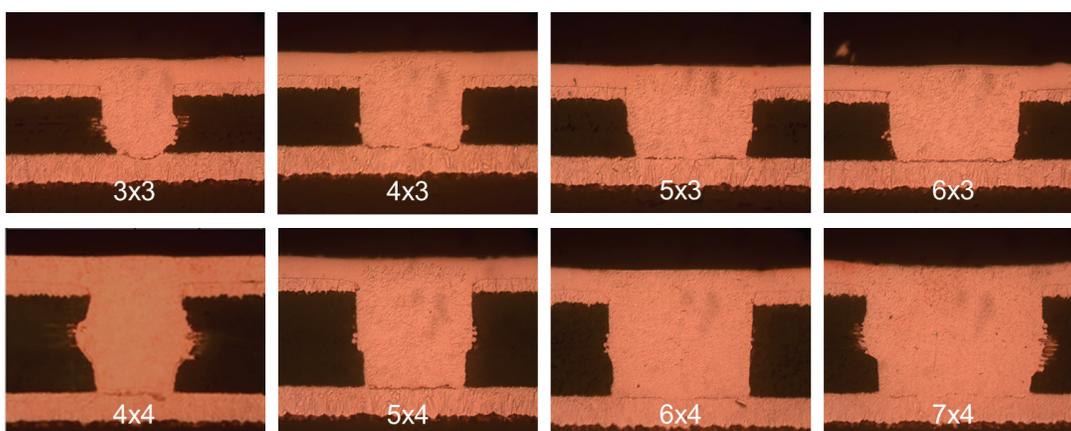
CIRCUITRY SOLUTIONS

MacuSpec AVF-700

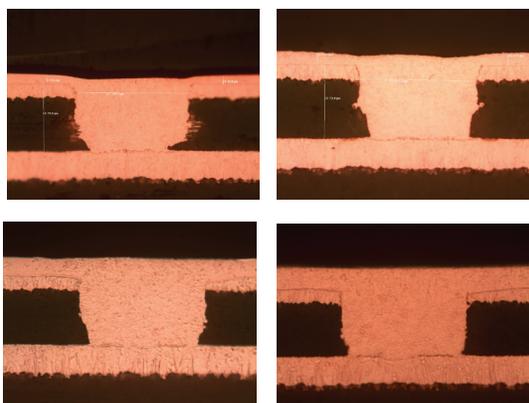
先进的填铜盲孔金属化

最佳的填铜盲孔工艺

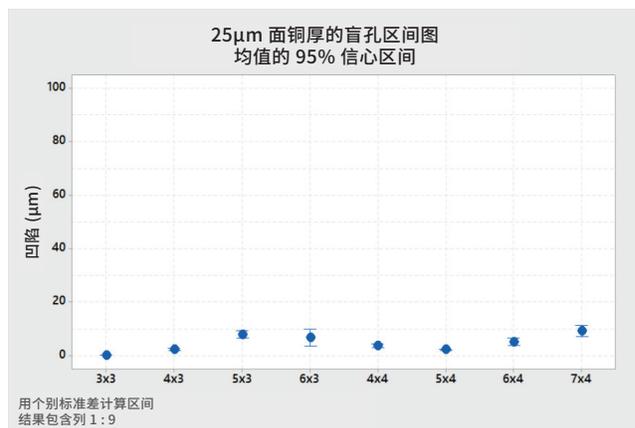
AVF 700是目前市场上最先进的填孔工艺之一，能够填平各种盲孔孔型，拥有高质量的物理特性而同时维持最小至12 μ m，最厚不超过25 μ m的面铜。



得到可靠、高质量的铜盲孔



具高再现性的填孔能力: AVF 700 填6x3 盲孔



我司累积学习自行业经验，AVF 700工艺性能具有出色的可再现性，同时符合IPC 6012D, 3.2.6.2 (抗拉强度不低于36,000 psi, 延展率不低于12%)，更改善了铜与铜结合力，其可靠度超出了行业的预期标准。使用AVF 700可以提升您的填孔能力、节约处理时间、提高良率。



macdermidalpha.com
October, 2019

MacDermid Enthone is a product brand of MacDermid Alpha Electronics Solutions.

© 2019 MacDermid, Inc. and its group of companies. All rights reserved.

® and ™ are registered trademarks or trademarks of MacDermid, Inc. and its group of companies in the United States and/or other countries.